



2002年7期

栏目:

DOI:

论文题目: Cu-Sn界面上金属间化合物生长的抑制

作者姓名: 任峰 高苏 张启运

工作单位: 北京大学化学系, 北京100871

通信作者: 张启运

通信作者Email: [qyzh@chem.pku.edu.cn](mailto:qyzh@chem.pku.edu.cn)

文章摘要: 用金相和润湿力测定的方法研究了带不同隔离层的Cu线在热浸Sn和电镀Sn制备电子元件引线时仓储可焊性的变化. 实验表明, Ni隔离层与Cu芯线的结合能力和保护能力最强, 但只适用于350℃以下热浸Sn工艺. Co隔离层则可完满地适用至450℃. Fe隔离层由于热浸Sn时往往局部破裂, 不能使Cu-Sn得到完全的隔离. Fe, Co, Ni隔离层在电镀法覆锡制备引线时均能获得良好的效果.

关键词: 金属间化合物, 电子元件引线, 隔离层, 钎焊

分类号: TG146. 1, TM24

关闭